证券代码：688126　　证券简称：沪硅产业　　公告编号：2022-021

上海硅产业集团股份有限公司 第一届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十次会议于 2022 年 4 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2022 年 3 月 31 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长俞跃辉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长俞跃辉先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告>的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

4、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2021 年度总裁工作报告>的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案的公告》。

8、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

9、审议通过《关于公司<截至 2021 年 12 月 31 日止年度上海硅产业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

12、审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

13、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

14、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

17、审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的公告》。

18、审议通过《关于子公司开设专项账户并签署监管协议的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

公司代码：688126　　公司简称：沪硅产业

上海硅产业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

√是　□否

公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的“市值及财务指标”条件：（四）预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元。上市时，公司尚未实现盈利。

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为 14,611.24 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-13,163.78 万元，尚未实现盈利（扣除非经常性损益前后净利润孰低者）。

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第一届董事会第四十次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，2021 年度利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	沪硅产业	688126	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	李炜	王艳
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号
电话	021-52589038	021-52589038
电子信箱	pr@sh-nsig.com	pr@sh-nsig.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料，是半导体产业链基础性的一环。然而，半导体硅片也是我国半导体产业链与国际先进水平差距最大的环节之一，虽然近年来国内半导体硅片产业取得了一定发展，但当前我国半导体硅片的供应仍高度依赖进口，国产化比例尚不及预期。公司作为我国半导体硅片领域的领先企业之一，肩负着提升国家产业安全的重任，正处于奋力追赶国际先进企业的进程之中。

公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一，也是中国大陆率先实现 300mm 半导体硅片规模化销售的企业。公司提供的半导体硅片产品类型涵盖 300mm 抛光片及外延片、200mm 及以下抛光片、外延片以及 200mm 及以下的 SOI 硅片。产品主要应用于存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片、功率器件、传感器、射频芯片、模拟芯片、分立器件等领域。

公司拥有众多国内外知名客户，包括台积电、联电、格罗方德、意法半导体、Towerjazz 等国际芯片厂商以及中芯国际、华虹宏力、华力微电子、长江存储、武汉新芯、长鑫存储、华润微等国内主要芯片制造企业，客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区。

截止本报告期末，子公司上海新昇 300mm 半导体硅片产能已完成 30 万片/月的安装建设，并启动新增 30 万片/月的扩产建设；子公司新傲科技和 Okmetic 200mm 及以下抛光片、外延片合计产能超过 40 万片/月；子公司新傲科技和 Okmetic 200mm 及以下 SOI 硅片合计产能超过 5 万片/月。

（二）主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，通过向下游芯片制造企业销售半导体硅片实现收入和利润。

2、采购模式

为保证公司产品的质量和性能，公司制定了严格的供应商选择和审核制度。达到经营资质、研发和设计能力、技术水平、质量管控能力、生产能力、产品价格、交货周期及付款周期等众多标准要求的供应商，才可以被考虑纳入公司合格供应商名录，并定期审核。目前，公司已经与全球众多供应商建立了长期、稳定的合作关系。

3、生产模式

公司主要实行以销定产的生产模式，大部分产品按订单批量生产，同时进行少量备货式生产。在生产方面，公司建立了生产管理制度，对生产过程中的各个因素进行控制，合理安排生产，协调各项生产活动，确保产品质量及交付满足规定的要求和客户的需求。在自主生产为主的同时，公司结合市场情况和自身产能利用情况，在部分非关键性技术生产环节适当配以外协加工进行辅助，以最大化满足市场需求。

4、销售模式

报告期内，公司全部产品均通过直销模式销售。由于半导体硅片的行业壁垒较高，生产企业和主要下游客户较为集中，公司通常采取主动开发潜在客户并与客户直接谈判的方式获取订单。同时，公司也通过少量代理商协助开展中小客户的接洽工作。

5、研发模式

公司是“产、学、研一体化”研发模式的践行者，未来将继续实行这一研发模式，继续与教学科研机构紧密合作，在公司改进自身技术的同时，促进中国半导体硅片行业的科学技术进步，提升中国半导体硅片的科研水平。公司将进一步加大核心产品相关技术的研发投入，在最前沿的单晶生长、切割、研磨、抛光、外延与 SOI 技术方面继续追赶国际先进水平。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业发展阶段

根据 SEMI 统计，2016 年至 2021 年间，全球半导体硅片（不含 SOI）销售额从 72.09 亿美元上升至 126.18 亿美元，年均复合增长率达 11.85%。2016 年至 2021 年间，中国大陆半导体硅片销售额从 5 亿美元上升至 16.56 亿美元，年均复合增长率高达 27.08%，远高于同期全球半导体硅片的年均复合增长率。2016 年至 2021 年间，全球 SOI 硅片市场销售额从 4.41 亿美元增长至 13.7 亿美元，年均复合增长率 25.45%。

报告期内，全球新冠疫情的反复变化持续影响产业发展。随着 5G 移动通信、汽车电子（智能网联汽车）、工业电子、人工智能、云计算、各类消费电子产品等终端市场需求的快速增长，行业“缺芯”的情况进一步加剧；全球汽车电子芯片供应紧绷，部分车企被迫间歇性停产。另一方面，在诸多因素的影响下，台积电、英特尔、格罗方德、三星等国际大厂纷纷加大资本开支，进行产能建设或技术升级。为应对国内外下游市场需求的强劲增长，我国主要的芯片制造企业也在加大 28nm 及以上成熟制程的逻辑产品、19nm 及以上制程的 DRAM 产品以及 64 层/128 层等 NAND 产品的产能扩张。

与此同时，受成本效益和技术进步驱动，半导体硅片具有从小尺寸到大尺寸、从成熟技术节点到先进技术节点发展的特点。从半导体硅片尺寸来看，目前商业化供应的半导体硅片尺寸主要为 100mm、125mm、150mm、200mm 和 300mm，其中 300mm 半导体硅片占据主流地位，300mm 半导体硅片的出货面积计占全球半导体硅片总出货面积的近 70%；从工艺技术节点上来看，目前国际上最先进的逻辑产品工艺技术节点为 5nm，但国内芯片制造企业仍以 14nm、28nm 及以上工艺为主。公司作为国内技术领先的半导体硅片企业，能够供应从 100mm 到 300mm 各种尺寸的半导体硅片，其中 300mm 半导体硅片产品已实现 14nm 及以上技术节点的全覆盖。

（2）行业发展的基本特点

半导体行业整体上呈周期性波动和螺旋式上升的趋势，半导体硅片行业的市场波动基本同步于整个半导体行业的波动周期。2021 年，虽然芯片行业遭遇史无前例的大缺货，但半导体产业的发展依然有其周期性。全球半导体产业已经进入“后摩尔定律时代”，在市场严重供不应求的情形下，面对新的挑战，在产能扩充的同时进行技术升级，是各个产业链环节上的企业抓住市场时机、探索相应机会的基础。

据 SEMI 统计，截止 2021 年底，全球有 19 座高产能芯片制造产线进入建设期，另有 10 座芯片制造产线将于 2022 年动工，由于一条芯片制造产线的月产能通常以三、五万片起跳，对半导体硅片用量也随之直线上升，但在市场供给有限、新产能还来不及开出的背景下，半导体硅片产业正迎来新一轮供不应求的市场机会。尽管目前国际主要半导体硅片企业均已宣布其扩产计划，但其预计产能仍无法完全满足全球范围内芯片制造企业对半导体硅片的增量需求，国内半导体硅片行业将迎来快速发展期。

（3）主要技术门槛

半导体硅片作为芯片制造的关键原材料，技术门槛较高，属于技术密集、人才密集行业。

产业链下游的半导体芯片制造通常采用不同工艺制程完成，不同的芯片制程工艺技术节点，对应于不同的特征尺寸和最小线宽，对半导体硅片晶体原生缺陷和杂质控制水平、硅片表面和边缘平整度、翘曲度、厚度均匀性等提出了不同的技术指标要求。下游芯片制程的技术节点越先进，特征尺寸越小，对应的硅片上述指标控制越严格，不同的技术节点对应的指标控制参数甚至会相差几个数量级。

公司经过多年的持续研发和生产实践，目前已掌握了包含 300mm 半导体硅片技术、200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 产品）技术等在内的可覆盖半导体硅片生产全流程的核心技术，具体包括晶体生长技术、切割技术、化学腐蚀技术、研磨技术、抛光技术、清洗技术、外延技术、SOI 制备技术与量测技术等。

公司坚持紧跟国际前沿技术，突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术，技术水平和科技创新能力国内领先。半导体硅片企业重视知识产权保护，目前仅有国际前五大半导体硅片厂商和公司具备 300mm 硅片大规模量产供应能力。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

半导体硅片行业是寡头垄断的行业，长期以来均被全球前五大硅片厂商垄断，包括日本的信越化学和 SUMCO、中国台湾环球晶圆、德国 Siltronic 和韩国 SK Siltron，上述五家企业合计占据 90%以上市场份额。

公司以全球前五大为目标，业务发展迅速、收入规模不断扩大，在全球半导体硅片市场份额持续提升。近三年（2019-2021 年）来，公司营业收入分别约为 14.9 亿元、18.1 亿元和 24.67 亿元。全球市场份额分别约为 1.8%，2.3%和 2.7%，市场占有率逐步提高。

2021 年下半年德国 Siltronic、日本 SUMCO 相继宣布启动大规模扩产，对半导体硅片市场未来的发展前景充满信心。公司作为国内规模最大、技术最全面、国际化程度最好的半导体硅片企业之一，将扩大规模、丰富产品结构、提高市场占有率作为公司业务的重要战略任务，通过 50 亿定向增发募投项目的实施，实现 300mm 半导体硅片产能的扩充和 300mm 高端硅基材料国内技术空白的填补，在保持国内领先地位的基础上，把握当前市场机遇，快速提升国际综合竞争力。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

集成电路制程亦称为工艺节点或特征线宽，即晶体管栅极宽度的尺寸，用来衡量半导体芯片制造的工艺水准。随着半导体制程的不断缩小，芯片制造工艺对硅片缺陷密度与缺陷尺寸的容忍度不断降低。对应在半导体硅片的制造过程中，需要更加严格地控制硅片表面微粗糙度、硅单晶缺陷、金属杂质、晶体原生缺陷、表面颗粒尺寸和数量等技术指标，这些参数将直接影响半导体产品的成品率和性能。

一般来讲，300mm 芯片制造对应的是 90nm 及以下的工艺制程，包括常见的 90nm、65nm、55nm、45nm、28nm、16/14nm、10/7nm、5/3nm 等；200mm 芯片制造对应的是 90nm 以上的工艺制程，包括常见的 0.13μm、0.15μm、0.18μm、0.25μm 等。

依照摩尔定律，集成电路朝着面积更小、速度更快、价格更便宜、能耗更低的方向前进。与此同时，大量应用如射频器件、传感器、功率器件等，考虑到实际技术需求和成本、可靠性等，可以在 28nm 及以上技术节点的成熟工艺生产线上制造，无需遵循摩尔定律。因此 28nm 以上的成熟技术节点硅片，仍存在大量需求。

总的来说，未来随着 5G/6G、人工智能、云计算、物联网、智能汽车等多种技术的发展和应用的拓展，半导体（硅片）一方面仍然会沿着摩尔定律向更先进的 5nm、3nm、2nm 制程前进，另一方面 28nm 以上的成熟制程仍将在很长一段时间内继续发展。两者共同促进智能社会、智慧生活的到来。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,625,671.274267	1,449,850.726428	12.13	996,324.41
归属于上市公司股东的净资产	1,042,193.241353	944,304.000705	10.37	507,201
营业收入	246,683.224814	181,127.780153	36.19	149,250.98
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	240,635.16	177,114.28	35.86	/
归属于上市公司股东的净利润	14,611.235176	8,707.084205	67.81	-8,991.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,163.78	-28,064.76	不适用	-23,737.45
经营活动产生的现金流量净额	30,748.958521	37,654.603638	-18.34	88,670.19
加权平均净资产收益率(%)	1.47	1.14	增加 0.33 个百分点	-2.06
基本每股收益(元/股)	0.059	0.038	55.26	-0.050
稀释每股收益(元/股)	0.058	0.037	56.76	-0.050
研发投入占营业收入的比例(%)	5.10	7.23	减少 2.13 个百分点	5.64

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	53,465.44	58,819.78	64,443.90	69,954.11
归属于上市公司股东的净利润	906.29	9,622.88	-463.22	4,545.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,559.13	-3,093.49	-2,615.08	-2,896.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,623.79	4,360.23	-710.99	28,723.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	70,991
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,541
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
上海国盛(集团)有限公司	0	567,000,000	22.86	567,000,000	567,000,000	无	0	国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	567,000,000	22.86	567,000,000	567,000,000	无	0	国有法人
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	-14,494,347	159,778,253	6.44	12,272,600	12,272,600	无	0	国有法人
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	-21,600,000	140,400,000	5.66	0	0	无	0	其他
上海新阳半导体材料股份有限公司	0	139,653,500	5.63	139,653,500	139,653,500	无	0	境内非国有法人
上海新傲科技集团有限公司	-23,260,000	138,740,000	5.59	0	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	55,500,636	55,500,636	2.24	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	10,607,702	46,601,598	1.88	0	0	无	0	其他
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金（有限合伙）	-67,856,604	28,622,259	1.15	0	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	22,152,306	22,152,306	0.89	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4 报告期末表决权优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 沪硅产业 MTN001	102102271	2024 年 11 月 10 日	500,000,000	3.58

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	未到期

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位：万元　币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	35.45	34.2	3.65
扣除非经常性损益后净利润	-13,163.78	-28,064.76	不适用
EBITDA 全部债务比	0.23	0.25	-8.00
利息保障倍数	3.21	2.51	27.66

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入为 246,683.22 万元，较上年同期增加 65,555.44 万元，增幅为 36.19%，主要是由于半导体市场需求旺盛，同时公司的产能不断爬升，公司产出和销售量均大幅上升。

随着营业收入的增加，公司报告期内营业成本和其他经营管理费用投入也有所增加。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688126　　证券简称：沪硅产业　　公告编号：2022-027

上海硅产业集团股份有限公司 关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022 年 4 月 11 日，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第四十次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）提供借款专项用于实施“集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目”（以下简称“300mm 高端硅片”），向控股子公司上海新傲科技股份有限公司（以下简称“新傲科技”）提供借款专项用于实施“300mm 高端硅基材料研发中试项目”（以下简称“300mm 高端硅基材料”）。董事会授权公司董事长及其授权人士行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2021］3930 号），公司于 2022 年 2 月向特定对象发行股票 240,038,399 股，每股发行价 20.83 元人民币，募集资金总额为人民币 4,999,999,851.17 元，扣除发行费用人民币 53,814,364.71 元后，实际募集资金净额为人民币 4,946,185,486.46 元。上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字（2022）第 0162 号《验资报告》予以确认。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露，本次募集资金主要用于“集成电路制造用集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目”、“300mm 高端硅基材料研发中试项目”和“补充流动资金”，具体使用情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金使用金额（万元）
1	集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目	460,351.20	150,000.00
2	300mm 高端硅基材料研发中试项目	214,420.80	200,000.00
3	补充流动性资金	150,000.00	150,000.00
合计		824,772.00	500,000.00

三、使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的情况

（一）借款事项基本情况

公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的募投项目中“300mm 高端硅片”的实施主体为公司全资子公司上海新昇。为了保障募投项目的顺利实施以及方便公司的管理，公司拟使用部分募集资金向上海新昇提供总额不超过人民币 15 亿元（含本数）借款专项用于实施“300mm 高端硅片”，借款期限为自借款发放之日起 5 年，利率为 0。本次借款仅用于“300mm 高端硅片”的实施，不得用作其他用途。若在借款期限内，上海新昇成为公司非全资子公司（以完成工商变更登记为准），则自完成工商变更登记之日起，转为按市场利率收取利息。

公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的募投项目中“300mm 高端硅基材料”的实施主体为公司控股子公司新傲科技。为了保障募投项目的顺利实施以及方便公司的管理，公司拟使用部分募集资金向新傲科技提供总额不超过人民币 20 亿元（含本数）借款专项用于实施“300mm 高端硅基材料”，借款期限为自借款发放之日起 5 年，按市场利率收取利息。

2022 年 4 月 11 日，公司第一届董事会第四十次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》。独立董事已发表了明确同意的意见。本次借款不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。

（二）本次借款对象的基本情况

1.上海新昇半导体科技有限公司

★ 统一社会信用代码：91310115301484416G

★ 成立时间：2014 年 06 月 04 日

★ 法定代表人：李炜

★ 注册资本：238,000 万元人民币

★ 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号 1-4 幢、6-19 幢

★ 公司类型：其他有限责任公司

★ 经营范围：一般项目：高品质半导体硅片、硅基半导体材料、半导体设备和零部件的研发、生产和销售，半导体材料与器件相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物进出口，技术进出口，企业管理咨询，非居住房地产租赁、机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

★ 股权结构：公司持股 100%

★ 主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日未经审计总资产 644,284.52 万元，净资产 225,294.66 万元，2021 年度未经审计营业收入 69,680.32 万元，净利润-745.81 万元。

2.上海新傲科技股份有限公司

★ 统一社会信用代码：91310000703479935 5

★ 成立时间：2001 年 07 月 25 日

★ 法定代表人：李炜

★ 注册资本：31,500 万元人民币

★ 公司住所：上海市嘉定区新洲路 200 号

★ 公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

★ 经营范围：研究、开发、生产、加工高端硅基集成电路材料、相关技术及相关产品，销售自产产品以及提供相关的技术咨询和售后服务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

★ 股权结构：公司持股 97.3%，Soitec S.A.持股 2.7%

★ 主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日未经审计总资产 168,164.93 万元、净资产 91,989.40 万元，2021 年度未经审计营业收入 80,272.18 万元、净利润 13,505.68 万元。

四、本次提供借款对公司的影响

本次公司使用募集资金向子公司提供借款是基于募投项目建设需要，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划及相关法律法规的要求。募集资金的使用方式与用途符合公司主营业务发展方向，有助于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

五、本次提供借款后的募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权利，上海新昇和新傲科技拟开立募集资金专项账户用于存放前述借款资金，董事会授权公司董事长及其授权人士行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部门具体实施相关事宜，包括办理与开立募集资金账户，以及签署公司、上海新昇、新傲科技、保荐机构、监管银行等之间的募集资金专户存储监管协议等相关事宜，对本次所涉及的募集资金建立专户存储，确保募集资金使用的合法、有效。公司将在本次借款到位后按照上海证券交易所要求及《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》与上海新昇、新傲科技、保荐机构、银行及时签订监管协议。

公司、上海新昇和新傲科技将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、等规定要求规范使用募集资金。

六、对使用部分募集资金向上海新昇提供借款实施募投项目履行的审议程序

2022 年 4 月 11 日，公司召开第一届董事会第四十次会议、第一届监事会第二十二次会议，同意公司使用部分募集资金向全资子公司上海新昇提供借款专项用于实施“300mm 高端硅片”，向控股子公司新傲科技提供借款专项用于实施“300mm 高端硅基材料”。董事会授权公司董事长及其授权人士行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构发表了专项核查意见。审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

七、监事会、独立董事和保荐机构的意见

（一）监事会意见

监事会认为：本次公司使用部分募集资金向子公司提供借款是基于募投项目建设需要，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划及相关法律法规的要求。募集资金的使用方式与用途符合公司主营业务发展方向，有助于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分募集资金向全资子公司上海新昇提供总额不超过人民币 15 亿元（含本数）借款专项用于实施“300mm 高端硅片”，向控股子公司新傲科技提供总额不超过人民币 20 亿元（含本数）借款专项用于实施“300mm 高端硅基材料”。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次公司将部分募集资金向子公司提供借款用于专项实施募投项目，不涉及原项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，上述事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施。同意公司使用部分募集资金向子公司提供借款用于专项实施募投项目。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的事项无异议。

八、上网公告附件

（一）独立董事关于公司第一届董事会第四十次会议审议的相关事项的独立意见

（二）海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的核查意见

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

证券代码：688126　　证券简称：沪硅产业　　公告编号：2022-022

上海硅产业集团股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会议于